第二十届全国包装工程学术会议
征文通知

全国包装工程学术会议作为国内包装工程领域历史最悠久、影响力最广的学术会议，自创办以来坚持为高校、科研院所与企业搭建学术和人才交流的桥梁，有力推动了包装技术与科学的发展。第二十届全国包装工程学术会议拟于2025年10月23-26日在云南昆明市召开。会议由中国振动工程学会包装动力学专业委员会主办，旨在深入交流最新的研究成果和技术进展，挖掘包装产业发展需求，促进产学研融合发展。现面向全国包装院校师生、企事业科研人员征稿，相关事项通知如下。

一、大会主题

低碳与智能包装

二、主办单位

中国振动工程学会包装动力学专业委员会

三、承办单位

重庆红智信信息技术有限公司

暨南大学

《包装工程》编辑部

四、征文主题

1．绿色包装材料与技术

（1）减量设计和生态设计；（2）环境友好型包装材料与制品；（3）包装废弃物循环利用技术；（4）功能性包装材料

2．智能包装技术与装备

（1）智能包装技术与智慧型包装制品；（2）智能包装设备与智能化包装过程；（3）包装成套装备共性技术；（4）AI技术应用

3．运输包装

（1）包装动力学；（2）储运包装与安全；（3）运输包装结构优化

4．食品包装与安全

（1）食品包装新技术；（2）包装渗透与迁移；（3）食品包装安全评价

5．农产品保鲜包装与物流技术

（1）气调保鲜技术；（2）活性包装技术；（3）冷链物流包装技术

6．包装印刷新技术

（1）绿色印刷材料与适性；（2）数字印刷技术；（3）包装印刷与印后加工新技术；（4）印品质量检测；（5）印刷与包装防伪技术

7．其他

（1）包装测试技术；（2）包装自动控制；（3）包装标准化等

五、投稿须知

本届会议面向国内外征集包装科技领域未在任何会议、期刊上发表过的最新研究论文或摘要。通过会议学术委员会及相关特邀专家评审的优秀论文，将由会议组委会推荐至 SCI、EI、中文核心等相关期刊发表。

论文投稿使用会议邮箱：icpts2025@163.com，投稿文件为 word 格式。

论文投稿截止时间：2025 年 9 月 25 日

六、会议联系

联系人：周建伟 13588088788　梁爱锋 15023087337

电话：023-68792294　　邮箱：icpts2025@163.com

网址：https://csve.kejie.org.cn/meeting/CPEC2025/

中国振动工程学会包装动力学专业委员会

2025 年 3 月 25 日